

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2026-014

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2026年第一季度业绩说明会，针对公司2026年第一季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2026年5月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司《关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2026-012），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2026年5月18日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2026年第一季度业绩说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2026年第一季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题1：**晶方科技一是费用端（特别是汇率和管理费）的压力何时缓解；二

是马来西亚基地和在建工程何时投产、贡献营收？

**回答：**您好，一季度费用端的波动仅是阶段性的影响，其中财务费用的增长主要系汇率波动所致，公司将通过平衡外币资产和负债结构，降低相关影响。子公司管理费用增加，主要系推动其应对国际贸易形式，积极获取客户订单、有效提升业务规模所致，相关费用的产生仅是阶段性的。

马来西亚生产基地已完成土地厂房购买相关的协议签署、资产交割，厂务系统、无尘室装修的施工接近尾声，并开始进入生产工艺与设备选型采购、团队组建与培训阶段，预计年底开始打样、试生产。感谢您的关注！

**问题 2：**公司正积极推进光电共封、光电互联等技术，以应对 AI 芯片、自动驾驶对先进封装的需求，本年度预计会产生多少营收是否有合同落地，还是单纯给股东画饼？

**回答：**您好，公司专注于集成电路先进封装技术服务，拥有晶圆级封装技术和晶圆级光学加工能力等技术优势，随着 AI 技术的快速发展，AI 芯片、自动驾驶、数据中心等新兴应用场景正不断对先进封装技术创新提出新需求，尤其是需要封装技术在有限空间内提供高密度互联方案，如堆叠、光电共封、光电互联等。公司作为晶圆级 TSV 封装技术的领先者，将继续密切关注产业动态与市场需求，积极加强技术储备、推进技术能力创新与市场应用拓展，不能确定具体的商业化落地进度，不存在您所说的画饼。感谢您的关注！

**问题 3：**目前马来西亚工厂的无尘室装修和设备搬入进展如何？预计今年具体哪个月份能够正式投产并开始贡献营收？该基地初期的产能规划主要面向哪些核心客户或市场领域？公司目前账上拥有超常规的巨额现金储备，除了日常运营和马来西亚建厂外，管理层在‘外延式并购’方面是否有明确的规划或正在接触的标的？未来是否会考虑通过并购来快速扩大营收规模，或者通过加大分红、回购等方式来积极回馈中小股东？随着 AI 芯片对先进封装需求的爆发，公司在 CPO（光电共封装）、光电互联等前沿技术上，目前是否已经有具体的样品送测或进入了头部客户的供应链验证阶段？与去年相比，今年在这些新兴业务上是否有明确的商业化落地时间表？

**回答：**马来西亚生产基地正在无尘室装修验收与设备装机阶段，生产工艺拓展、团队组建与培训等工作正在同步开展，预计年底进入打样试生产阶段。公司

马来西亚海外生产基地项目旨在提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,客户信息为公司商业信息,公司具有保密义务。

公司资产质量优良,盈利与现金流能力良好,公司充足的现金储备由良好的盈利能力积累而来,也是公司未来持续发展的坚实基础。公司将一如既往的顺应市场与产业发展需求,加大技术工艺自主研发创新与先进技术的并购拓展,积极推进国际化的研发、业务、生产制造能力布局,进一步巩固提升自身的产业链地位。

公司在光电共封等新兴领域的拓展布局情况请详见前述回复,感谢您的关注!

**问题 4:** 您好,请问公司最近有新签订单或者准备签的订单么?

**回答:** 基于商业合作保密约定,具体合作企业及业务细节不便披露,公司将依规披露重大业务合作事项,请以公告为准。感谢您的关注!

**问题5:** 一、AI光互联与1.6T光模块领域: 1、目前公司在1.6T光模块相关的硅光衬底TSV封装技术上的良率表现如何?随着光模块向CPO/OIO路线演进,公司与头部光引擎厂商在2.5D/3D先进封装领域的联合研发项目,预计在2026年下半年能贡献多少营收占比? 2、在AI算力需求持续旺盛的背景下,公司针对光电异构集成(Chiplet)的技术储备是否已经实现从‘技术研发’向‘量产导入’的跨越?目前在手订单中,来自数据中心高速通信类业务的订单排产情况如何? 二、汽车电子领域: 1、随着Robotaxi及商用车辅助驾驶系统成本的大幅下降,公司12英寸车载CIS封装产线的产能利用率目前是否已接近饱和?苏州新扩建的产线在上半年的达产进度是否符合预期? 2、在激光雷达封装领域,公司与头部Tier 1厂商合作的晶圆级微型阵列镜头目前是否已进入大规模量产阶段?针对全固态激光雷达的先进封装方案,公司目前的市场占有率目标是多少? 3、公司参股公司VisIC在车规级GaN功率器件上的进展如何? 2026年是否已实现在主流合资或国产新能源品牌车型上的定点或小批量装车?

**回答:** 您好,关于公司在光电共封等新兴领域的拓展布局情况请详见前述回复。

随着汽车智能化的快速发展,车规CIS、激光雷达、智能投射等产品应用需求不断增长。公司为全球车规CIS晶圆级TSV封装技术的领先者,行业优势地位显著,车规CIS封装业务规模呈现快速增长趋势,车载晶圆级微型阵列镜头业务、

激光雷达封装业务已实现量产。公司目前产能利用状态良好，并将通过生产能力的有效提升，满足客户与市场需求。

公司投资的以色列VisIC公司为全球领先的第三代半导体GaN(氮化镓)器件设计公司,正在积极开发基于硅基氮化镓技术的400V//650V/800V等逆变器方案，其D3GAN技术具有导通电阻低，开关频率高，损耗小，可靠性高等特点。目前VisIC公司将车用逆变器领域作为主要拓展领域之一，正积极和知名汽车厂家或TIER1厂商进行芯片及模块设计的合作。

**问题6：**请问公司在玻璃基板/TGV、CPO光互联封装等前沿先进封装领域，目前的技术进展、客户拓展情况如何？未来是否有产能扩张或市场份额提升的具体目标？

**回答：**公司专注于传感器领域晶圆级TSV先进封装技术服务。关于在光电互联等新兴领域的拓展布局情况请见前述回复，感谢您的关注！

**问题7：**安特永光电官网产品介绍其中的光学透镜阵列可用于光纤阵列，请问相关产品在光通信领域产品竞争力怎么样？是否已有订单产生？

**回答：**您好，公司荷兰子公司Anteryon具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力，业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品，感谢您的关注！

**问题8：**请问控股的安特永光电生产的有硅光透镜产品吗？市场需求以及产能如何？

**回答：**您好，关于公司子公司光学业务情况请见前述回复，感谢您的关注！

**问题9：**公司作为牵头单位推进的国家重点研发计划“智能传感器”重点专项——“MEMS传感器芯片先进封装测试平台”项目进展如何？对公司未来发展会有怎样的积极影响？

**回答：**您好，该项目为公司牵头承担的国家重点研发计划项目，项目针对高端MEMS传感器先进封装测试需求，建立基于标准的面向图像传感器、硅麦克风、加速度计、陀螺仪、压力传感器、红外传感器、流量传感器等高端传感器的先进封装测试公共服务平台，目前项目技术工艺开发、客户拓展、商业化应用等均有效推进实施，项目正处于验收结题阶段。该项目的有效实施将进一步推进公司在先进封装技术领域的技术领先优势与制造服务能力，有力提升公司在高端MEMS

领域的市场拓展与业务规模。

**问题10:** 晶方科技高管，你荷兰子公司投资也多年了，作为你股东，持仓也有八个月，十分关心荷兰子公司的进展，从年报上看有营收，但亏损，什么时候可扭亏盈利。子公司的产品在国内市场是顶极的。我对晶方科技在国内，国外的企业十分关注。谢谢了！

**回答:** 您好，公司荷兰子公司Anteryon具备全球领先的微型光学设计、研发与制造等核心能力，业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工、光学系统模块集成等技术与产品。并购荷兰子公司后，公司通过积极运营整合与技术业务协同，有效推进Anteryon的产品技术开发与市场客户拓展，近年来其业务规模显著增长，盈利能力显著提升。基于Anteryon在光学领域领先的技术能力、核心客户群体、市场发展与需求趋势，其业务有望保持快速增长趋势，感谢您的关注！

**问题11:** 你好，主要想了解关于贵公司以下几个情况:1、目前公司订单量如何，业务量是否有受到手机消费市场下滑的影响？2、海外参股公司VISIC目前合作进展如何？是否考虑建立合资公司进一步推进产品国产化？3、未来马来西亚工厂是主要承接海外新客户订单，还是将目前国产订单转移至海外生产？

**回答:** 公司目前生产经营有序开展，业务拓展稳步推进，订单与业务情况保持良好。虽然手机消费电子市场景气度承压，但受益于汽车智能化的快速发展，对CIS等智能传感器产品的市场需求将有效增加，公司作为全球智能传感器领域先进封装技术的领先者，将通过技术的持续创新、生产能力的有效布局，积极把握市场机遇。

公司投资的以色列VisIC公司为全球领先的第三代半导体GaN（氮化镓）器件设计公司,正在积极开发基于硅基氮化镓技术的400V//650V/800V等逆变器方案，其D3GAN技术具有导通电阻低，开关频率高，损耗小，可靠性高等特点。目前VisIC公司正聚焦车用逆变器、数据中心功率模块等应用领域，通过与知名汽车厂家、TIER1等厂商合作进行芯片及模块的设计、开发与验证。

公司马来西亚海外生产基地的布局，是为了有效应对国际贸易争端与地缘政治博弈风险，在全球产业链重构整合新趋势中，顺应客户要求，承接巩固海外客户订单，从而保持公司在全球产业新分工中的产业地位，感谢您的关注！

**问题12：**请问公司目前在3D异构集成、晶圆级封装、TSV 工艺等高端先进封装技术上整体进展如何？十二英寸产线对应的技术落地、良率提升与产能释放节奏怎样？面向高速算力与光电融合领域，公司后续技术迭代方向、核心技术壁垒以及全年规模化量产与业务落地规划能否简要说明？

**回答：**您好，公司专注于集成电路先进封装技术服务，为全球领先的智能传感器先进封装技术开发商与服务商，拥有8英寸、12英寸晶圆级TSV封装产线，具备从晶圆级到芯片级的综合封装服务能力，尤其在晶圆级TSV先进封装技术领域，公司拥有技术、生产、市场、客户等方面显著的领先优势。

公司目前12英寸晶圆级TSV等产线的产能利用状态良好，并将通过技术工艺的创新迭代，持续提升生产能力与效率，满足客户与市场需求。

公司在光电融合等新兴领域的拓展布局情况请详见前述回复，感谢您的关注！

**问题13：**能具体介绍一下贵公司在光通信，光互连方面优势和布局。

**回答：**您好，相关问题请见前述回复，感谢您的关注！

### **三、其他事项**

关于本次业绩说明会的具体内容，详见价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年5月19日